

合肥顾中科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025-009

投资者关系活动类别	☒特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☒业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演/反路演活动 ☒现场参加 ☒电话会议 ☐其他（请文字说明其他活动内容）
来访单位名称	中邮证券、申万宏源、富安达基金、宏利基金、国金电子、兴业证券、中信建投、东北证券、开源电子、招商电子、天风证券、方正电子、华泰证券、广发基金等
时间	2025 年 10 月 29 日-2025 年 10 月 30 日
上市公司接待人员姓名	总经理：杨宗铭 副总经理、董事会秘书、财务总监：余成强
投资者关系活动主要内容介绍	1. 问：公司 2025 年第三季度的经营情况如何？ 答：2025 年第三季度，公司实现营业收入 6.09 亿元，同比增长 21.42%，环比增长 16.76%；归母净利润 8,534.88 万元，同比增长 28.58%，环比增长 22.38%。 2. 问：公司对于下半年的展望？ 答：2025 年下半年，显示芯片封测业务方面，显示产业转移效应持续发酵，尤其大尺寸 COF 和 TDDI COG，叠加国补延续，赛事等因素，第三季度需求快速拉升，第四季度预期可再增量；小尺寸 TDDI 维修与品牌预期继续增量；AMOLED 渗透率持续提高。非显示芯片封测业务方面，Cu bump 2025 年第二季度也有所增长，下半年预计亦逐季增量；DPS 虽 2025 年上半年稼动率不佳，但下半年有所回升；FCQFN/FCBGA/FCLGA 新制程建置 2025 年上半年有客户开始认证，下半年开始小量量产，整体维持审慎乐观的预期。 3. 问：公司 2025 年第三季度按制程别来看占营收的比例如何？ 答：2025 年第三季度，BUMP 占比约 47%，CP 占比约 19%，COF 占比约 24%，COG 占比约 9%，DPS 占比约 1%。 4. 问：2025 年第三季度，AMOLED 的营收占比？ 答：2025 年第三季度，AMOLED 营收占比约 17%。

	5.问：公司产品终端应用的营收占比？ 答：公司结合产品指标、下游客户收入结构等特性，分析封测芯片的主要终端应用领域情况。根据公司初步统计：2025 年第三季度，显示业务方面，智能手机占比约 46%，高清电视占比约 32%，笔记本电脑约为 6%；非显示业务方面，电源管理占比约 73%，射频前端占比约 18%。 6.问：如果未来黄金价格下降，是否会影响产品的毛利率？ 答：黄金主要用于显示驱动芯片上，而公司目前生产上所用到的黄金成本基本可转嫁至下游客户，由其承担价格波动的主要风险，因此黄金价格波动对公司产品毛利影响不大。 7. 问：公司可转换债券的募投项目高脚数微尺寸凸块封装及测试项目的竞争优势？ 答：显示驱动芯片封测行业正面临重要的技术发展机遇。金凸块作为主流封装材料，在电性能、可靠性和工艺成熟度方面具备显著优势，是高端显示驱动芯片封装的重要技术选择。但随着下游应用市场的不断扩大，特别是在消费电子领域，市场对更具性价比的封装解决方案需求日益增长。铜镍金凸块技术通过在铜基底上镀覆镍层和薄金层的结构设计，在满足此类市场需求的同时实现了成本的有效控制，为显示驱动芯片封装提供了新的技术选择。 从技术布局来看，发展多元化的封装技术路线，能够更好地满足不同细分市场的需求。金凸块技术将继续发挥其性能优势，而铜镍金凸块技术则可以满足对成本更为敏感的应用领域需求。这种差异化的技术布局有助于企业更好地服务不同类型的客户，扩大市场覆盖范围。 该募投项目将布局铜镍金凸块工艺产线，形成多元化的技术服务能力。通过优化产品结构和成本结构，增强公司在不同细分市场的竞争优势。 8. 问：公司 2025 年 1-9 月的折旧金额是多少？ 答：2025 年 1-9 月合肥厂和苏州厂合计的折旧金额约为 3.5 亿元。
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	本次活动，公司严格按照相关规定交流沟通，不存在未公开重大信息泄露等情形。
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 10 月 30 日